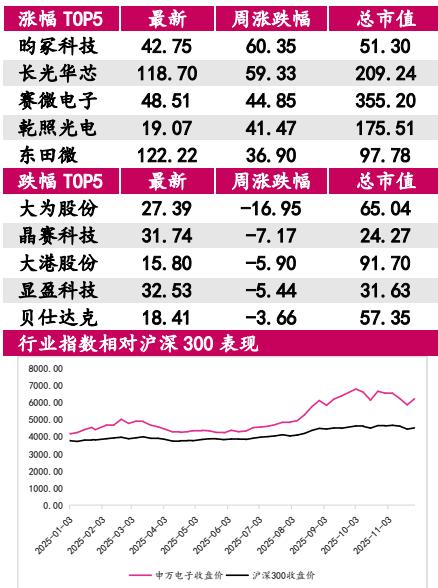




电子行业 2025年11月30日



相关报告

- 【金元电子】周报 20251019 英伟达发布 800VDC 白皮书，“功率墙”应予以重视
- 【金元电子】周报 20251026 谷歌将量子优势的概念从随机任务推进到可重复验证、具备应用潜力的新阶段
- 【金元电子】周报 20251109 寒武纪优化基础软件平台，或加速国产算力落地
- 【金元电子】周报 20251117 中芯国际三季度产品结构、产能利用率改善，毛利率超预期
- 【金元电子】周报 20251123 谷歌推出 Gemini 3 Pro，推理、多模态、长上下文能力提升

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

行业周度点评报告

一太空数据中心建设，开启“天地协同”新方案 评级：增持（维持）

- 全行业：**本周上证指数上涨1.40%，深证成指上涨3.56%，沪深300指数上涨1.64%，申万电子版块上涨6.05%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为2/31。板块个股涨幅前五名分别为：昀冢科技、长光华芯、赛微电子、乾照光电、东田微；跌幅前五名分别为：大为股份、晶赛科技、大港股份、显盈科技、贝仕达克。
- 电子行业：**电子行业呈现普涨且涨幅分化显著的格局。从申万二级行业数据看，各子板块均录得上涨，其中元件板本周上涨8.10%，为本周表现最强的方向；其下申万三级行业印制电路板上涨8.87%、光学元件上涨8.75%，成为板块领涨细分领域。其他电子II板块整体上涨7.59%，其下申万三级行业其他电子III同样上涨7.59%，走势完全一致。半导体板块整体上涨5.72%，内部结构差异较大，模拟芯片设计子板块上涨7.26%、数字芯片设计上涨6.40%，成为板块核心拉动力量；半导体设备上涨5.42%，细分领域表现亮眼。消费电子板块上涨6.08%，延续回暖态势，消费电子零部件及组装上涨6.23%对板块形成主要支撑，品牌消费电子上涨4.52%。光学光电子板块上涨5.23%，其中LED上涨7.71%，成为板块内表现突出的细分领域；面板上涨2.38%，涨幅相对温和。电子化学品II板块上涨3.93%，其下申万三级行业电子化学品III同幅上涨3.93%，走势同步。总体来看，本周电子行业全板块上涨且分化明显，元件领涨，其他电子II、半导体、消费电子等多个细分领域表现活跃，行业呈现整体性回暖且内部涨幅差异较大的态势。
- 行业要闻：**
 - “智绘星空胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”在北京的召开
 - 美国或批准英伟达向中国出售H200人工智能芯片
 - 长鑫存储推出国产DDR5和LPDDR5X两大高速新品
 - Meta计划使用Alphabet的AI晶片，可能挑战辉达地位
 - 打造顶级效能与体验，高通正式推出Snapdragon 8 Gen 5旗舰平台
 - AI推动记忆体短缺，消费电子与汽车产业受排挤
- 公司动态：**
 - 赛微电子：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
 - 好利科技：2025年前三季度权益分派实施公告
 - 万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
 - 思瑞浦：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
 - 拓荆科技：2022年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告
- 投资建议：**我们认为，太空算力中心在能源获取成本（晨昏轨道优势）、电网负荷、土地资源、太空背景温度具有一定优势，但是核心挑战在于三个方面，一是在于高能辐射对AI芯片、存储的影响，或导致算力失效；二则是GW级散热难题，虽然太空背景温度低，但是太空没有空气对流就意味着没有散热介质，热量需要通过红外辐射散发到深空；三则是太空分布式计算的通信挑战。根据本次方案安排，我们认为第一阶段值得关注的是抗辐射算力解决方案及散热；二、三阶段则聚焦于太空组网所涉及到的激光通信及相干、高阶调制技术。相关公司包括：1、特种IC、FCBGA：紫光国微、航宇微、复旦微电、臻雷科技等；2、散热材料：中石科技、全信股份等；3、自由空间激光通信：福晶科技、腾景科技、光库科技、航天电子等
- 风险提示：**1、技术不确定性：当前太空算力中心仍处于技术验证阶段，在辐射、热控、通信方面仍存在较高不确定性，如理论上的辐射散热在工程实现上极其困难。如果散热效率达不到设计指标，AI芯片将不得不降频运行，导致算力成本飙升，商业模型不可行；2、维护与升级难题：地面数据中心可以随时更换故障硬盘或升级显卡。太空需要昂贵的在轨服务任务（On-orbit Servicing）。如果OSAM技术（在轨服务、组装和制造）进展不及预期，太空数据中心或进展缓慢；3、地缘政治与监管风险：太空数据的管辖权、跨境流动、以及太空设施军事化的风险。

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前金元在先

目录

一、核心观点	3
二、行业跟踪	9
三、行业新闻	12
四、公司公告	19
五、下周重要事件提示	24

图表目录

图 1：晨昏轨道优势	4
图 2：HPDP+RTG4 FPGA 架构	5
图 3：HPDP 上层架构	6
图 4：射频链路 (RF) vs 激光链路 (OISL)	7
图 5：本周各行业版块涨跌幅	9
图 6：本周电子版块：子版块涨跌幅	11
图 7：电子板块历史走势	12
图 8：电子板块历史市盈率	12
表 1：本周电子板块个股涨幅前五名	10
表 2：本周电子版块个股跌幅前五名	10
表 3：下周重要会议	24
表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）	25

一、核心观点

据新华网报，2025年11月27日，“智绘星空胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”在北京的召开，揭开了中国首个系统性太空算力工程的面纱。

根据推进会上发布的规划方案，太空数据中心建设计划在未来十年内，通过三个阶段的迭代，最终建成一个功率达到 GW 级的在轨算力集群：

- **第一阶段（2025 年-2027 年）：技术验证与试验星发射。**这一阶段的核心任务是“从 0 到 1”的突破。主要目标是研制并发射第一代试验卫星，如“辰光一号”。技术攻关的重点在于验证高功率密度下的能源获取与散热技术，以及在轨计算单元的抗辐射性能。这一阶段并不追求大规模组网，而是要在真实的太空环境中跑通“发电-计算-散热-通信”的最小闭环。北京轨道辰光科技作为核心实施主体，已经完成了首轮融资。目前，创新联合体已突破一系列关键核心技术，完成第一代试验星“辰光一号”产品研制，正在开展总装试验，拟于今年底或明年初择机发射。建设一期算力星座，计划总功率达 200KW、算力规模达 1000POPS，实现“天数天算”应用目标。
- **第二阶段（2028 年-2030 年）：在轨组装与成本优化。**进入这一阶段，计划的重点转向工程化与经济性。单个火箭的运力终究有限，无法一次性将 GW 级的数据中心送入轨道。因此，需要突破在轨组装建造技术。未来的太空数据中心将像搭建空间站一样，通过多次发射，将计算模块、能源模块和散热模块分别送入轨道，利用空间机器人进行自动对接与组装。这一阶段还将重点解决降低建设与运营成本的问题，探索商业闭环的可能性。
- **第三阶段（2031 年-2035 年）：大规模组网与 GW 级实现。**这是本次计划的终极形态。届时，卫星将实现大规模批量化生产，并通过高频次的发射进行大规模组网。最终在轨形成一个拥有数千个节点、总功率达 1000MW (1GW) 的宏伟计算设施，不仅服务于中国的数字经济，更有望成为全球太空基础设施的重要组成部分。

在选址方面，计划明确将数据中心部署在高度为 700-800 公里的晨昏轨道。晨昏轨道是一种特殊的太阳同步轨道（Sun-Synchronous Orbit, SSO）。在这种轨道上，卫星的轨道面始终与太阳光线保持垂直（或接近垂直），卫星沿着地球的晨昏线（即白天与黑夜的分界线）飞行，其优势在于三个方面：1、全天候光照，卫星几乎全年处于阳光照射下，很少进入地球阴影区，能源稳定性高，通过太阳能电池可以持续发电，极大减少重量较大的电池组；2、热环境稳定；3、覆盖能力强。

图 1：晨昏轨道优势

特性	描述	对太空数据中心的意义
全 天 候 光 照	卫星几乎全年处于阳光照射下，很少进入地球阴影区（食区）。	能源稳定性： 这是实现 GW 级供电的关键。普通低轨卫星每 90 分钟就要经历一次约 30 分钟的黑暗，需要沉重的电池组来维持供电。而在晨昏轨道，太阳能电池板可以持续发电，极大地减少了对储能电池的依赖，降低了发射重量和成本 ² 。
热 环 境 稳 定	卫星的一侧始终朝向太阳，另一侧始终朝向深空。	散热设计简化： 在普通轨道，卫星经历频繁的冷热交替 (-100°C 到 +100°C)，热控系统极其复杂。在晨昏轨道，可以设计固定的“冷面”和“热面”，利用背阳面高效向深空辐射散热，这对高发热的算力载荷至关重要 ² 。
覆 盖 能 力	既然是极轨卫星，它可以覆盖全球所有纬度。	全球服务： 能够为全球任意地点的用户提供数据服务，具有极高的商业价值和战略威慑力。

数据来源：金元证券研究所整理

太空环境与地面最大的不同在于高能辐射。银河宇宙射线 (GCR)、太阳高能粒子 (SEP) 以及地球辐射带中的俘获粒子，都会对半导体器件造成致命伤害。主要的辐射效应包括：

- **总电离剂量效应 (TID)**：长期辐射导致器件性能退化、阈值电压漂移，最终失效
- **单粒子效应 (SEE)**：高能粒子穿过芯片敏感区，引发单粒子翻转 (SEU，导致数据错误) 或单粒子锁定 (SEL，导致大电流烧毁芯片)。

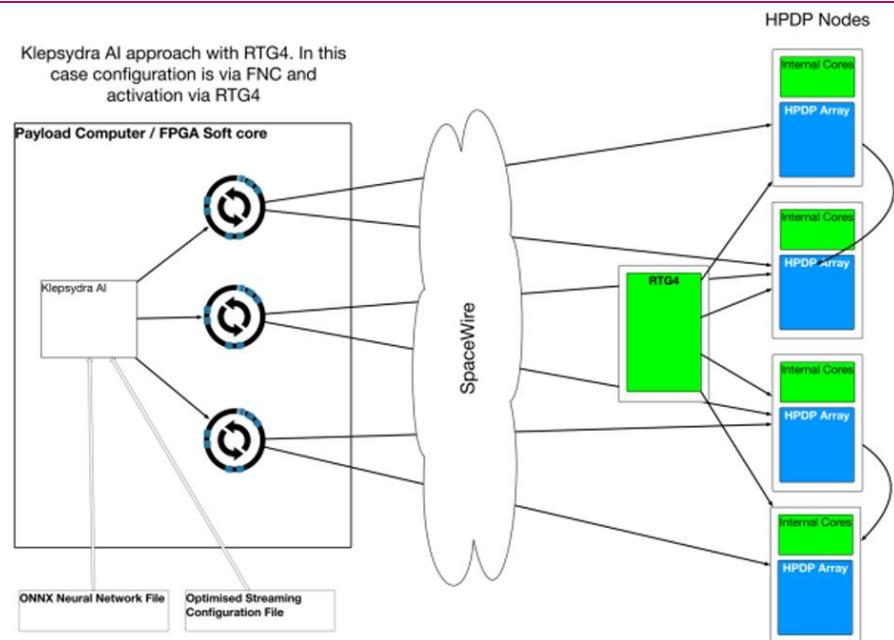
太空 AI 芯片的选择上需要充分考虑高能辐射影响，技术路线上分为两种。一种是使用特殊半导体工艺（如 SOI 绝缘体上硅）和加固设计（如三模冗余电路），从物理底层设计上抵抗辐射。但是缺点也较为明显，制程相对落后，如欧比特的“玉龙 810”，虽然可以在物理层面防止辐射影响，单芯片算力 (12 TOPS) 与当前 AI 算力芯片差距较大。

另一种是在现有芯片基础上，提升软硬件容错，或也是太空数据中心的主流路线。直接使用地面的高性能算力芯片通过软件算法和系统架构解决辐射问题。技术原理上，通过冗余设计增加芯片数量同时计算 (TMR)，一旦某颗芯片结果不一致就进行重启。

论文《Achieving Dependability of AI Execution with Radiation-Hardened Processors》使用高性能芯片阵列 (HPDP) 作为辐射硬化协处理器，其动态重配置能力和数据流架构非常适合 AI 任务（如卷积操作）。HPDP 与 Microchip

Technology 的 RTG4 FPGA（集成 LEON3 处理器）协同工作，后者作为主协调器，管理数据流和 AI 工作负载触发。同时，Klepsydra AI 框架提供锁免执行和高效资源管理，进一步优化吞吐量。这一方案允许 AI 框架直接利用 HPDP 作为数学后端，无需额外硬件编码。

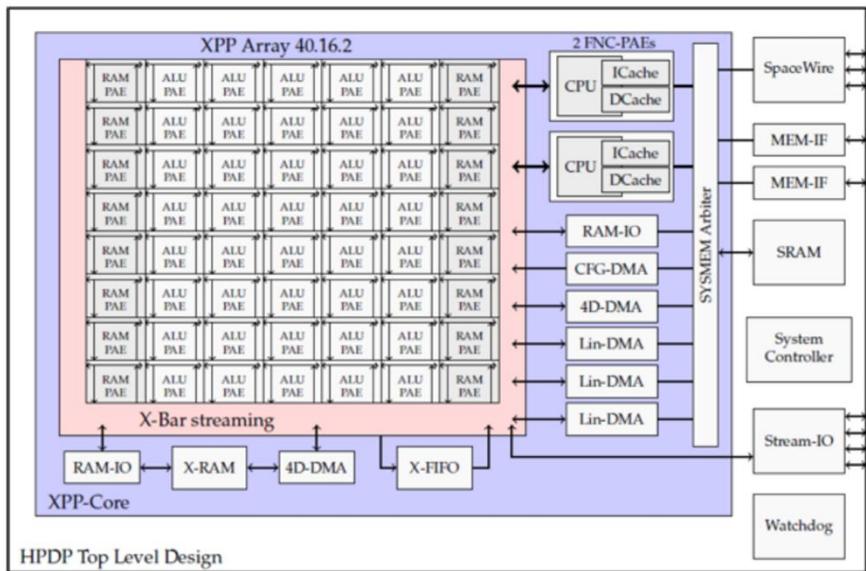
图 2：HPDP+RTG4 FPGA 架构



数据来源：《Achieving Dependability of AI Execution with Radiation-Hardened Processors》，金元证券研究所整理

HPDP 基于 XPP-III 核心，是一种动态可重配置处理阵列：ALU-PAEs 是 40 个算术逻辑单元，以 5x8 矩阵排列，支持并行计算；RAM-PAEs 拥有 16 个存储单元，位于 ALU 阵列两侧，用于数据缓存。接口模块：包括 4D-DMA（复杂地址数据传输）、SpaceWire 接口（外部通信）和 Stream-I/O（数据流处理）。HPDP 架构以数据流为导向，数据在 PAEs 间连续流动，实现高吞吐量（时钟速度达 250 MHz）。

图 3: HPDP 上层架构



数据来源:《Achieving Dependability of AI Execution with Radiation-Hardened Processors》, 金元证券研究所整理

另外,利用AI算法本身的鲁棒性(神经网络对少量权重错误不敏感)来容忍比特翻转。同时,利用内存清洗(Scrubbing)技术定期修复翻转的比特。此外,Google的Suncatcher计划明确提出使用TPU进行在轨计算,测试显示其v6e TPU在经历相当于5年的辐射剂量后仍未出现硬件故障,不过内存(HBM)亚系统是相对敏感的。

除了辐射影响外,散热也是太空数据中心面临的物理瓶颈。在地面,1GW的热量可以通过巨大的冷却塔和蒸发水带走。在太空,没有空气对流就意味着没有散热介质,热量需要通过红外辐射(Radiation)散发到深空。根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann Law),辐射散热功率 $p = \epsilon\sigma A (T^4 - T_s^4)$ 。其中A是散热面积,T是散热器温度。由于芯片工作温度不能过高(通常低于85°C),这意味着要散去1GW的热量,需要数万甚至数十万平方米的散热面积。其解决方案包括展开式巨型散热阵列、两相流体回路、液滴散热器以及深空冷源。展开式巨型散热阵列类似国际空间站的散热翼,但规模要大得多。这要求散热翼须是可折叠、轻量化的柔性材料。液滴散热器(Liquid Droplet Radiator)是一种激进的技术。直接将热的液滴喷射到太空中,液滴在飞行过程中辐射散热,冷却后再被收集器回收。这种方式可以获得巨大的表面积-质量比,是解决GW级散热的潜在终极方案,但面临液滴损失和污染的风险。利用深空冷源是晨昏轨道的优势在于散热面可以始终避开太阳,直面2.7K的深空背景,从而最大化辐射效率。

除辐射、散热挑战外,太空数据中心互联也是一大挑战。太空数据中心本质上是一个分布式的超级计算机。成百上千颗卫星需要像地面机房里的服务器一样高速互联。星间链路(Inter-Satellite Links, ISL)作为这一架构转型的核心物理

层技术，不再仅仅是卫星通信的辅助手段，而是构建天地一体化信息网络的骨干神经。

传统的卫星通信模式严重依赖于卫星与地面站（Gateway）之间的频繁交互。在这种架构下，卫星本质上是一个太空中的信号中继器，其数据传输受限于地面站的地理分布、可视时间窗以及频谱资源的可用性。这种“星地依赖”模式在面对全球覆盖需求时显得捉襟见肘，特别是在海洋、极地以及地缘政治敏感区域，地面站的部署往往面临物理或政治上的不可行性。星间链路技术的引入，彻底打破了这一桎梏。通过在卫星之间建立直接的数据传输通道，OISL 使得数据可以在太空中进行多跳路由，从地球的一端传输到另一端，而无需经过地面中转。这不仅极大地降低了对地面基础设施的依赖，实现了真正意义上的全球无缝覆盖，还通过光速在真空中的传播优势，实现了比地面光纤网络更低的端到端时延。

星间链路的物理层实现主要分为射频（RF）链路和光学（Laser/OISL）链路两大类。尽管射频技术在航天领域有着长达半个世纪的成熟应用，但随着对带宽需求的指数级增长，物理层特性的限制使得激光通信（OISL）逐渐成为下一代大规模航天领域应用的必然选择。

图 4：射频链路（RF） vs 激光链路（OISL）

核心维度	射频链路（RF）	激光链路（OISL）	技术原理与战略影响深度分析
物理波束特性	波束发散角较大（度级），导致能量在传播过程中迅速扩散。	波束发散角极窄（微弧度级），能量高度集中。	能量效率与侦测难度： 激光的高能量密度意味着在相同发射功率下，接收端可获得极高的信噪比（SNR）。同时，极窄波束使得链路极难被截获（LPI/LPD 特性），除非敌方侦测器恰好位于直径仅几百米的波束截面内。这在军事应用（如 SDA 星座）中具有无可替代的战略价值。
频谱资源与监管	频谱极其拥挤，主要集中在 Ka、V、E 频段，受 ITU 严格监管。	频谱资源近乎无限，主要使用 1064nm 或 1550nm 波段，目前基本处于非监管状态（Unregulated）。	部署速度与法律风险： RF 频谱的协调往往需要数年时间，且面临严重的相邻卫星干扰风险。相比之下，激光通信无需申请频率许可，极大地加速了巨型星座的部署进程，规避了日益复杂的频谱地缘政治博弈。
传输带宽能力	典型值为 Mbps 至数 Gbps 级，受香农极限和可用带宽限制。	典型值为 Gbps 至 Tbps 级，理论上限极高。	未来扩展性： RF 难以支撑未来 6G 时代 Tbps 级的空间干线传输需求。目前在轨验证的激光链路已达 200Gbps（Starlink/TBIRD），且具备向数 Tbps 演进的物理基础。
大气环境敏感度	相对较不敏感，但在高频段（V/E band）雨衰显著。	极其敏感，受云层、气溶胶、大气湍流影响严重。	应用场景分化： 这一特性决定了 OISL 最完美的舞台是真空环境的星间通信。若用于星地链路（S2G），则必须引入昂贵且复杂的自适应光学（AO）系统来补偿大气湍流引起的波前畸变。
工程实现难度	天线对准容差大，技术成熟，成本较低。	需亚微弧度级的捕获、跟踪与瞄准（PAT）精度，光机系统极其复杂。	技术门槛： RF 链路的门槛较低，而 OISL 的 PAT 系统涉及高频振动抑制、热稳定性控制等精密制造难题，是目前制约产能和成本的关键瓶颈。

数据来源：金元证券研究所整理

从物理层本质来看，激光通信相较于 RF 具有约 1000 倍的带宽潜力。随着低地球轨道 (LEO) 拥挤程度的加剧，RF 频段的空间复用难度呈指数级上升，而 OISL 凭借其极窄波束实现的“空间与频谱极致复用”，成为唯一能支撑数万颗卫星互联且互不干扰的技术路径。

在早期的卫星激光通信实验中（如 SILEX 项目），主要采用强度调制/直接检测 (IM/DD) 技术（如 OOK 调制）。OOK 调制结构简单，但其灵敏度低，抗背景噪声能力差，难以支持长距离、超高速率传输。现代星间链路，特别是以 Starlink 和 SDA 标准为代表的新一代系统，已经全面转向了源自地面光纤通信的相干光通信 (Coherent Optical Communication) 技术。相干光通信的核心在于利用本地振荡器 (Local Oscillator, LO) 与接收到的信号光进行混频。根据光外差探测原理，相干接收机不仅能探测信号光的强度（幅度），还能完整恢复其相位和频率信息。

相干调制的三大核心优势在于：

- **灵敏度跃升 (Shot-noise Limited)**：由于本振光功率远大于信号光功率，交叉项的增益使得信号能够轻易从热噪声中浮现出来。相较于 IM/DD，相干检测可获得更高的灵敏度增益。在链路预算上，这意味着在相同的激光发射功率下，通信距离可延伸数倍，或者在同等距离下，望远镜口径可以显著缩小，这对寸土寸金的星载终端 SWaP (尺寸、重量、功耗) 指标至关重要。
- **高阶调制与频谱效率**：能够利用相位维度携带信息，支持 QPSK、8PSK、16QAM 等高阶调制格式。例如，Starlink V2 及后续版本被推测采用 DP-QPSK 或 16QAM 调制，以在有限的硬件带宽下实现 100Gbps 乃至 200Gbps 的吞吐量。
- **强抗干扰与背景光抑制**：由于混频过程具有极强的频率选择性（类似于无线电中的外差接收），只有与本振光频率极度接近的信号才会被放大，这使得相干接收机天然具备对太阳光等宽带背景噪声的免疫力，支持全天候（日/夜）工作。

中国在星间/星地激光通信领域已取得多项世界级突破，部分指标甚至领先全球。长光卫星技术股份有限公司于 23 年 6 月通过 500 毫米口径激光通信地面系统与吉林一号 MF02A04 星开展了星地激光通信试验，通信速率达到 10Gbps（每秒 10G 比特）。2024 年 1 月，进一步实现了星间激光 100Gbps 超高速传输，并成功下传高分辨率遥感影像。

我们认为，太空算力中心在能源获取成本（晨昏轨道优势）、电网负荷、土地资源、太空背景温度具有一定优势，但是核心挑战在于三个方面，一是在于高能辐射对 AI 芯片、存储的影响，或导致算力失效；二则是 GW 级散热难题，虽然太空背景温度低，但是太空没有空气对流就意味着没有散热介质，热量需要通过红外辐射散发到深空；三则是太空分布式计算的通信挑战。根据本次方案安排，我们认为第一阶段值得关注的是抗辐射算力解决方案及散热；二、三阶段则聚焦于太空组网所涉及到的激光通信及相干、高阶调制技术。

相关公司：

- 1、特种 IC、FCBGA：紫光国微、航宇微、复旦微电、臻雷科技等
- 2、散热材料：中石科技、全信股份等
- 3、自由空间激光通信：福晶科技、腾景科技、光库科技、航天电子等

风险提示：**1、技术不确定性：**

当前太空算力中心仍处于技术验证阶段，在辐射、热控、通信方面仍存在较高不确定性，如理论上的辐射散热在工程实现上极其困难。如果散热效率达不到设计指标，AI 芯片将不得不降频运行，导致算力成本飙升，商业模型不可行。

2、维护与升级难题：

地面数据中心可以随时更换故障硬盘或升级显卡。太空需要昂贵的在轨服务任务（On-orbit Servicing）。如果 OSAM 技术（在轨服务、组装和制造）进展不及预期，太空数据中心进展缓慢

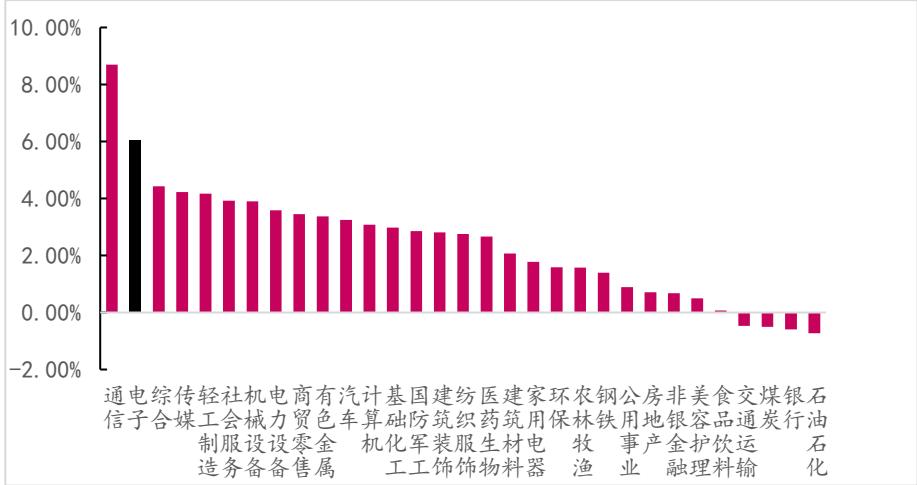
3、地缘政治与监管风险：

太空数据的管辖权、跨境流动、以及太空设施军事化的风险。

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.11.24–2025.11.28）上证指数上涨 1.40%，深证成指上涨 3.56%，沪深 300 指数上涨 1.64%，申万电子版块上涨 6.05%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 2/31。板块个股涨幅前五名分别为：昀冢科技、长光华芯、赛微电子、乾照光电、东田微；跌幅前五名分别为：大为股份、晶赛科技、大港股份、显盈科技、贝仕达克。

图 5：本周各行业版块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价(元)	周最低价(元)	周最高价(元)	周换手率	周成交量(万手)	周成交金额(亿元)
688260.SH	矽家科技	60.35	42.75	26.66	43.95	47.84	57.41	20.80
688048.SH	长光华芯	59.33	118.70	73.47	122.00	64.21	113.19	115.56
300456.SZ	赛微电子	44.85	48.51	33.63	50.51	159.34	951.98	397.24
300102.SZ	乾照光电	41.47	19.07	13.68	19.07	68.60	628.62	101.50
301183.SZ	东田微	36.90	122.22	88.61	122.22	80.42	47.15	49.33

数据来源：Choice，金元证券研究所

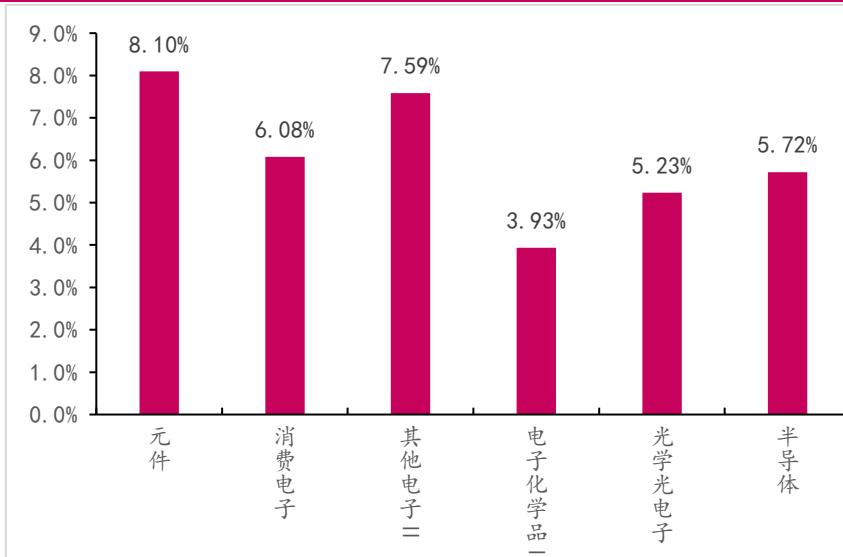
表2：本周电子版块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价(元)	周最低价(元)	周最高价(元)	周换手率	周成交量(万手)	周成交金额(亿元)
002213.SZ	大为股份	-16.95	27.39	26.13	32.60	115.57	238.87	67.80
871981.BJ	晶赛科技	-7.17	31.74	31.45	35.06	16.23	6.05	2.02
002077.SZ	大港股份	-5.90	15.80	15.29	16.71	32.41	188.09	29.89
301067.SZ	显盈科技	-5.44	32.53	32.26	35.69	32.51	20.75	6.96
300822.SZ	贝仕达克	-3.66	18.41	18.00	19.99	18.21	52.61	9.97

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业：本周（2025.11.24 - 2025.11.28）电子行业呈现普涨且涨幅分化显著的格局。从申万二级行业数据看，各子板块均录得上涨，其中元件板块本周上涨 8.10%，为本周表现最强的方向；其下申万三级行业印制电路板上涨 8.87%、光学元件上涨 8.75%，成为板块领涨细分领域。其他电子Ⅱ板块整体上涨 7.59%，其下申万三级行业其他电子Ⅲ同样上涨 7.59%，走势完全一致。半导体板块整体上涨 5.72%，内部结构差异较大，模拟芯片设计子板块上涨 7.26%、数字芯片设计上涨 6.40%，成为板块核心拉动力量；半导体设备上涨 5.42%，细分领域表现亮眼。消费电子板块上涨 6.08%，延续回暖态势，消费电子零部件及组装上涨 6.23% 对板块形成主要支撑，品牌消费电子上涨 4.52%。光学光电子板块上涨 5.23%，其中 LED 上涨 7.71%，成为板块内表现突出的细分领域；面板上涨 2.38%，涨幅相对温和。电子化学品Ⅱ板块上涨 3.93%，其下申万三级行业电子化学品Ⅲ同幅上涨 3.93%，走势同步。总体来看，本周电子行业全板块上涨且分化明显，元件领涨，其他电子Ⅱ、半导体、消费电子等多个细分领域表现活跃，行业呈现整体性回暖且内部涨幅差异较大的态势。

图 6: 本周电子版块: 子版块涨跌幅



申万二级行业	周涨跌幅	申万三级行业	周涨跌幅
半导体	5.72	分立器件	4.85
		半导体材料	4.44
		数字芯片设计	6.40
		模拟芯片设计	7.26
		集成电路封测	4.57
		半导体设备	5.42
元件	8.10	印制电路板	8.87
		被动元件	4.57
		面板	2.38
光学光电子	5.23	LED	7.71
		光学元件	8.75
		品牌消费电子	4.52
消费电子	6.08	消费电子零部件及组装	6.23
		电子化学品III	3.93
电子化学品	3.93	其他电子III	7.59
其他电子	7.59		

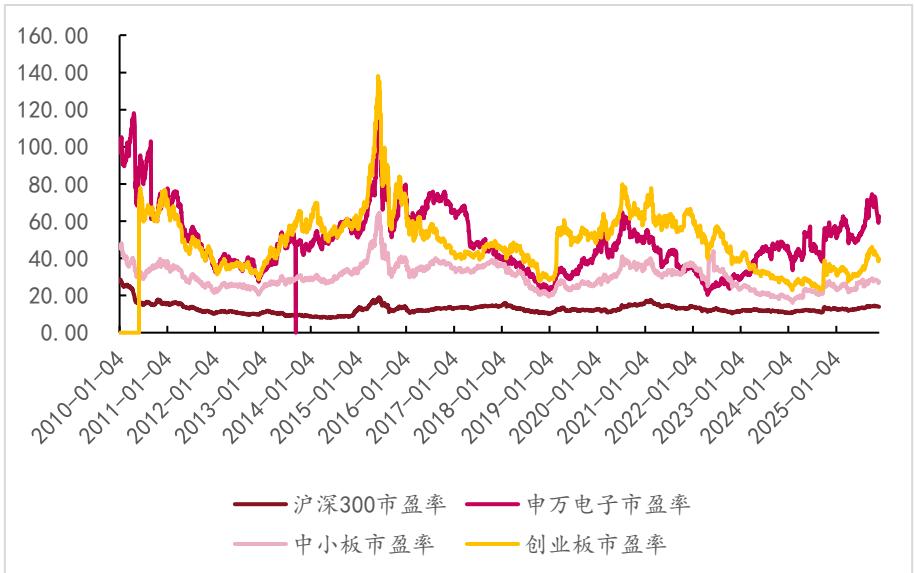
数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 7：电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 8：电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

滤波器暗战，卓胜微再遭村田跨国专利诉讼

11月24日据《电子工程专辑》报道，全球电子元器件巨头株式会社村田制作所已在德国对卓胜微及其全资子公司Maxscend Technologies (HK) Limited发起专利侵权诉讼，索赔约820万元，要求判令被告立即停止在德销售、召回侵权产品，披露商业数据并承担全部诉讼费用，且申请判决可临时执行。卓胜微明确不认可村田的诉讼主张，并将深度结合中韩两地的诉讼经验积极应诉，延续其“精准反击”的核心防御逻辑。数据显示，作为全球SAW滤波器霸主，

村田手握2.3万项专利，长期垄断安卓手机供应链。但其全球市场份额已从2020年的53%下滑至2025年的41%，而卓胜微滤波器业务营收占比已达28%。可以看出，专利战已成为村田延缓竞争的无奈之举。

美国或批准英伟达向中国出售H200人工智能芯片

11月24日据《电子工程专辑》报道，知情人士透露，特朗普政府正在考虑批准英伟达向中国出售其先进的H200人工智能芯片的计划。此举标志着美中关系在技术贸易领域出现缓和迹象，为美国先进技术对华出口提供了新的可能性。自2022年以来，美国政府禁止英伟达向中国出口用于AI应用的高端GPU，包括A100、H100和H200等型号。然而，近期美中关系的缓和为这一政策带来了转机。H200芯片作为英伟达首款搭载HBM3e存储器的GPU，与前一代A100相比，存储器容量提升近一倍，带宽提高约2.4倍，最高可达141GB容量与每秒4.8TB的传输速度，使其在执行推论任务时具备更强效能。尽管尚未做出最终决定，且该计划可能因国安考量或国会压力而调整，但此消息已引发市场广泛关注。英伟达股价于当地时间21日攀升至盘中高点，涨幅高达2%。

闻泰科技再发声明，敦促安世荷兰切实回应

11月24日据《电子工程专辑》报道，近日，全球半导体产业再次因闻泰科技与其全资子公司安世荷兰之间的控制权争端而受到关注。11月23日，闻泰科技通过其官方公众号发布《关于敦促安世荷兰切实回应沟通解决控制权问题以保障全球供应链稳定的声明》，就近期控制权争端及全球供应链稳定问题表达了严正立场。闻泰科技表示，将继续采取一切法律手段，最大限度维护公司及全体股东的合法权益。公司敦促荷兰经济部正视本次事件的本质，尽快、彻底纠正其错误，永久性撤销基于《货物可用性法案》发布的行政令，撤回其对企业法庭的参与及支持，确保中方股东的合法控制权及中方人员的合法权利得到恢复。

台积电董事长魏哲家直言先进制程产能远远不够

11月24日据《IT之家》报道，台积电董事长、CEO魏哲家与董事长刘德音上周共同获颁美国半导体产业协会年度最高荣誉罗伯特·诺伊斯奖。在AI算力提升先进制程需求急速攀升之际，魏哲家在典礼谈话中罕见直言先进制程“不够、不够、还是不够”。在致辞时，魏哲家与刘德音均回顾双方共事近三十年的历程，并强调这份荣耀属于整个台积电团队。这是台积电继2008年由创办人张忠谋获奖后，再度由前后任领导者同时获得最高荣誉。谈到AI驱动的先进制程需求时，魏哲家直指客户需求远超预期。他透露，依照各家大客户的产品规划与成长预期来看，台积电现有产能大约还差3倍，先进制程产能不够、不够、还是不够。他甚至笑称原本想穿着No more wafer字样的T-shirt上台，暗示晶圆需求强劲到难以消化。

文件显示亚马逊数据中心规模远超预期，在全球50多国拥有900多处设施

11月24日据《IT之家》报道，据彭博社与调查网站SourceMaterial查阅的文件显示，亚马逊公司的数据中心运营规模远超外界普遍认知，在全球50多个国家拥有逾900处设施。根据上述文件，AWS在数百个所谓“托管”设施中部署了服务器机架。截至去年，这些租赁空间提供的算力约占亚马逊可用计算资源

源总量的五分之一。出于安全考虑以及防止竞争对手获取运营细节，AWS并未公开单个数据中心的具体位置。当前正值投资者迫切希望了解 AWS是否具备足够算力以满足人工智能带来的巨大计算需求之际，这些文件为外界揭示了亚马逊云计算业务的真实面貌。同时，文件还表明，AWS是全球最大的托管数据中心空间承租方之一，这使其能够灵活地在全球范围内为客户提供多样化服务。

记忆体涨价与2奈米高昂成本，高通与联发科在2026年面临价格压力

11月25日据《科技新报》报道，随着半导体制程迈入2奈米制程时代，高通与联发科正为其下一代旗舰晶片，即骁龙8 Elite Gen 6与天玑9600的推出进行准备。然而，这两家晶片制造商不仅需要向晶圆代工龙头台积电支付高昂的2奈米制程费用，现在更必须应对LPDDR6 DRAM价格的急剧上涨。市场消息指出，由于LPDDR6记忆体价格不断攀升，下一代记忆体技术预计将只会应用于Snapdragon 8 Elite Gen 6与Dimensity 9600旗舰级晶片中，而且预计只有Pro等級的晶片将在2026年搭载LPDDR6 RAM晶片。这意味着，虽然LPDDR6技术代表着性能的提升，但其高昂的成本将使其在初期难以普及到非旗舰级设备。因此，包括晶圆代工与记忆体上涨的双重成本压力，预计将对高通和联发科的智慧型手机合作伙伴造成巨大负面影响。

AI影像SoC高阶新品明年放量，杰霖科技预计12月底挂牌上柜

11月25日据《科技新报》报道，杰霖科技11月26日将举办上柜前业绩发表会，预计12月底挂牌交易，董事长梁春林表示，今年推出的新品6580及2580系列，主攻客户端的高阶产品市场，已经进入小批次量产，预计明年将会放量，作为主要的成长动能。梁春林补充，杰霖科技在通讯模组领域也持续扩张，目前透过嵌入式平台、通讯介面与特殊环境应用等方案，逐步建立高壁垒客群，其产品延伸至国防相关与专业级通讯设备领域，为整体通讯模组事业注入稳定需求，形成多元化的营收来源。

记忆体缺货太严重，2026年微软可能出现停产危机

11月25日据《科技新报》报道，随着全球DRAM与GDDR6记忆体模组短缺加剧，微软正考虑再次提高Xbox Series X与S主机的价格。根据报道，此消息已传达给零售合作伙伴，情况比以往的供应问题更为严重。微软在2025年已两度调涨Xbox主机价格，并同步提高Game Pass订阅费用，此次若再次调价，将进一步改变游戏主机市场的格局。此次价格上涨的主因，除了美国对中国加征30%关税外，更关键的是AI与资料中心需求暴增，导致GDDR6记忆体价格飙升。目前微软尚未正式宣布再次调价的具体日期与金额，但若记忆体短缺持续，不排除2026年出现库存短缺或停产的可能。玩家若计划购买新主机，建议密切关注市场动态，并比较竞争对手的价格与方案。

长鑫存储推出国产DDR5和LPDDR5X两大高速新品

11月25日据《科技新报》报道，中国记忆体厂长鑫存储在2025年中国国际半导体博览会上正式发表首批DDR5与LPDDR5X产品，提供16Gb、24Gb与12Gb、16Gb等密度，全面进军伺服器、桌机、笔电与AI终端市场。长鑫存储展示的DDR5产品最高速度可达8000MT/s，并推出UDIMM、SODIMM、RDIMM、CSODIMM、CUDIMM

与TFF MRDIMM等完整模组组合，涵盖资料中心到消费性PC的各类应用。同步亮相的LPDDR5X采用12Gb与16Gb晶粒，速度最高10,667MT/s，可形成12GB至32GB的容量配置，产品将提供给轻薄笔电、嵌入式平台以及部分AI终端装置，满足更高密度的储存需求。根据TrendForce数据，长鑫存储2025年底产能将攀升至每月30万片，较目前增加近50%；Counterpoint亦预测其今年DRAM出货量年增约50%，市占率将从第一季的6%持续提升至第四季的8%，未来在资料中心与PC市场的渗透率值得关注。

日本“先进制程新势力”Rapidus将于2027年建设1.4纳米晶圆厂

11月25日据《科技新报》报道，据科技媒体Tom's Hardware今天报道，号称“先进制程新势力”的日本Rapidus最近宣布，计划于2027财年开始建设下一代1.4纳米晶圆厂，预计于2029年在北海道投产。台积电已于今年上旬公布其1.4纳米技术，将在明年全面启动这一先进制程的研发工作，此计划有望帮助这家晶圆厂缩小与“芯片巨头”台积电之间的差距。虽然Rapidus可以说是“含着金汤匙出生”，但它需要与台积电、三星、英特尔等业界巨头展开激烈竞争才能赢得市场认可；另一方面，这家日本芯片厂仅预计在2027年下半年开始在千岁制造厂量产2nm制程工艺晶圆，而且哪怕是成熟的代工厂在量产之前都会遇到良率问题，这意味着Rapidus很有可能一样会面临这种挑战。

台积电在新竹、高雄筹备2奈米厂，续在台湾投资先进制程

11月26日据《科技新报》报道，台积电将在台湾南科特定区再投资建造3座2奈米厂。台积电下午回复表示，将继续在台湾投资先进制程和先进封装设施，有关台积电产能投资相关资讯，依公司公告为准。台积电重申，正在台湾新竹和高雄科学园区筹备数期的2奈米晶圆厂，台积电也正在台中进一步拓展先进制程产能，例如A14制程技术。台南市政府今天表示，目前未接获台积电拟在南科特定区设厂讯息，若接获业者提出需求，将依法全力配合。台积电积极在台湾扩充先进制程，在台湾的新竹宝山、高雄、嘉义、台中等四大基地同步扩产。

Meta计划使用Alphabet的AI晶片，可能挑战辉达地位

11月26日据《科技新报》报道，Google母公司Alphabet Inc.的股价在最新交易中大涨2.7%，主要受Meta Platforms Inc.计划2027年采用Alphabet自研的人工智慧晶片张量处理单元（TPU）于自家资料中心的影响。据《The Information》报导，Meta不仅正在与Alphabet洽谈直接购买TPU晶片，还计划自2026年起向Google Cloud租用TPU算力，这将使双方合作关系更为紧密，并进一步挑战目前辉达在AI晶片市场的主导地位。目前Meta的AI业务重度依赖辉达GPU晶片，而转向使用Google TPU有望降低对辉达的依赖，同时可能引发辉达与AMD股价下跌的市场反应，反映出投资者对竞争格局变化的警觉。

记忆体模组比SONY PS5游戏主机价格还贵，市场供不应求程度令人吃惊

11月26日据《科技新报》报道，个人电脑市场正经历一场前所未有的价格危机，其中又以最新的DDR5记忆体的价格飙升最为显著。根据PCMAG UK的报导，PC记忆体的定价已经达到令人咋舌的水准，一套64GB的DDR5记忆体模组现在轻易就能超过500美元，甚至比一台Sony PlayStation 5游戏主机还要昂贵。分析认为，DDR5价格的爆炸性成长主要归咎于对AI资料中心庞大的需求，这

些需求正持续消耗市场上的记忆体供应。这场AI热潮已经引起了PC DIY社群的强烈不满。市场观察人士担忧，AI需求不仅影响了记忆体模组，还可能导致固态硬盘短缺，进而推高SSD的定价。这种记忆体的供应吃紧状态，可能代表在2026年，智慧型手机、笔记型电脑和其他电子产品价格也会随之变贵。

AI服务器需求激增，富士康获准向美国威斯康星州追加投资5.69亿美元

11月26日据《IT之家》报道，在美国客户对人工智能服务器的需求激增之际，富士康科技集团已获准向威斯康星州追加投资5.69亿美元，用于建设人工智能基础设施。富士康表示，计划中的这笔追加投资旨在满足美国客户对AI服务器日益增长的需求，并加强国内供应链。富士康表示，过去几年，已经在威斯康星州投入超过二十亿美元，涵盖薪资支出、资本支出和税费，在服务器生产领域创造了约1500个就业岗位。根据Omdia报告，富士康已成为全球最大的服务器供应商，主要得益于美国云服务提供商对AI服务器的强劲需求。该公司与英伟达建立了紧密合作关系，负责生产Blackwell GPU参考设计的服务器，并成为向云厂商供应NVL36 和 NVL72机架的主要供应商。此外，富士康还与苹果合作在美国生产AI服务器，包括采用M系列芯片的 Private Cloud Compute服务器系统。

戴尔将全年AI服务器出货额从200亿上调至250亿美元

11月26日据《IT之家》报道，戴尔科技集团上调全年AI服务器市场预期，反映数据中心热潮持续推高需求。戴尔在本财年第三季度取得123亿美元的AI服务器订单，完成56亿美元的出货，季度末未完成订单达到184亿美元。戴尔同时把全年出货额预测由原先的200亿美元提高到250亿美元。戴尔在10月大幅调高未来两年的销售与利润增速预期，并表示AI相关需求将把增长势头延续至2030财年。戴尔基础设施部门的本季度运营利润率为12.4%，高于分析师平均预期的11.2%。戴尔整体毛利率为21.1%，同样高于市场平均预期的20.4%。财报发布后，戴尔股价在盘后上涨约2%，报125.92美元。今年以来股价已累计上涨9.3%。

辉达称旗下GPU领先Google TPU股价跌幅骤缩

11月27日据《科技新报》报道，Facebook母公司Meta Platforms Inc. 正在协商，打算2027年斥资数十亿美元在资料中心使用Google研发的张量处理单元。对此，辉达强调旗下产品仍较整个业界领先一个世代，早盘重挫逾7%的股价也随之收敛。原本有望跃居AI晶片市场二哥的辉达对手超微，股价表现则惨淡。分析人士直指，辉达AI GPU的市占率目前超过90%，但Google自行研发的TPU最近几周却逐渐受到瞩目，不少人相信这是替代辉达昂贵Blackwell晶片的可行方案。跟辉达不同，Google并未对外贩售TPU，仅将其用于内部任务，并允许其他业者透过Google Cloud云端部门租赁TPU。Google 11月稍早发布的Gemini 3大获好评，这个先进AI模型就是以TPU训练、而非使用辉达GPU。

打造顶级效能与体验，高通正式推出Snapdragon 8 Gen 5旗舰平台

11月27日据《科技新报》报道，高通11月26日宣布推出Snapdragon 8 Gen 5行动平台，将为顶级智慧手机带来旗舰级的效能、智慧与体验。从AI与相机技术的创新，到沉浸式游戏体验，Snapdragon 8 Gen 5以顶级定位为核心，

满足市场对尖端效能日益攀升的需求。高通资深副总裁暨行动终端装置事业部总经理Chris Patrick表示，随着顶级智慧型手机的需求持续攀升，Snapdragon 8 Gen 5能完美契合甚至超越消费者不断提升的期待。高通重新构思8系列产品，让全球更多消费者能体验顶级效能。Snapdragon 8 Gen 5以使用者的行动体验为核心，提供高速、智慧且高效的行动体验，助其发挥最佳表现，全面释放创意潜力。Snapdragon 8 Gen 5将率先搭载于全球多家OEM厂商与智慧型手机品牌的旗舰装置，包括iQOO、摩托罗拉、一加和vivo。

传英特尔可超频版Nova Lake配备144MB bLLC，对决AMD处理器

11月27日据《科技新报》报道，英特尔下一代Nova Lake处理器的快取配置出现新的爆料。最新消息指出，只有可超频型号将搭载bLLC增强快取。消息来源@Jaykihn表示，bLLC将限于未锁频SKU，且总快取容量可能达到144MB，甚至有传闻指出旗舰版本可能提升至180MB。大容量快取技术方面，AMD目前布局较为成熟。3D V-Cache已成功应用于Ryzen X3D系列处理器，以3D封装将额外快取堆叠于处理器模组上方，以提升快取命中率并降低延迟，对游戏与高随机读取场景皆带来明显效能提升。这使得X3D系列在游戏市场维持长期优势，也成为英特尔bLLC需要面对的主要竞争对手。Nova Lake预定2026年推出，AMD下代Zen 6处理器仍将延续3D V-Cache技术。双方在大容量快取与游戏效能竞争预料持续升温，bLLC能否协助英特尔缩短差距，也将成为后续观察焦点。

ChromeOS结合Android，征才启事曝Google打造Aluminium OS

11月27日据《科技新报》报道，Google高层曾经暗示要把ChromeOS与Android合并，打造新的PC作业系统，如今因为一则征才启事带来更多线索。外媒Android Authority报导中的征才内容，显示Google正在招募一名资深产品经理，负责一款名为Aluminium OS的新系统，Aluminium OS以Android为基础，而Google正在考虑让该系统搭载在入门、中阶到高阶不同市场定位的硬体上。这不代表ChromeOS将会立即退出市场，至少短期不会。征才启事指出，团队将负责打造一系列采用ChromeOS和Aluminium OS的装置，涵盖笔电、折叠装置、平板、盒装设备等形式，还有不同价格带。Android Authority去年报导指出Google制定新计划，Google Android生态系统总裁萨玛特也公开表示，采用ChromeOS的使用体验，并以Android重新调整其底层技术，这样的结合将在2026年实现。

AI推动记忆体短缺，消费电子与汽车产业受排挤

11月28日据《科技新报》报道，随着人工智能基础设施的快速扩张，科技公司如戴尔科技、惠普与联想集团等，纷纷发出警告，预示未来一年内可能出现记忆体晶片供应短缺。这个需求激增的趋势，让消费电子产品制造商如小米也开始担心价格上涨的风险。根据市场研究机构Counterpoint Research的报告，记忆体晶片价格在今年已上涨50%，预计2026年将再增长20%。业界人士指出，记忆体制造商如三星电子、SK海力士与美光，正优先供应AI伺服器所需的高阶记忆体，导致消费性电子与汽车产业的产能遭排挤。记忆体价格上涨已压缩电脑硬体毛利率，戴尔、惠普等业者股价重挫。业界预期，2026年整体记忆体需求将远超今年，供需紧张局面恐持续。

建兴储存科技推出16TB企业级ER4系列SATA SSD，随机读写效能居业界之冠

11月28日据《科技新报》报道，面对AI伺服器与资料中心对高密度、低延迟储存的快速增长需求，建兴储存科技宣布推出新一代企业级固态硬碟ER4系列SATA SSD。本系列容量最高可达16TB，为市场上少数能提供极大容量的SATA SSD之一；同时具备高达98K/30K IOPS的随机读写效能。而8TB版本更提供98K/55K IOPS的卓越表现，兼具大容量与优异效能，适用于AI推理、即时分析与高并发环境。透过高速控制器与优化韧体设计，ER4系列可支援高交易密度的稳定运行，也适用于虚拟化、云端基础架构、大数据平台、中小企业NAS、备份系统与影像监控等多元场景，协助企业在不更动硬体架构的前提下，大幅提升整体效能与储存效率。建兴储存科技表示，未来将持续拓展企业级SSD产品线，并投入更多技术于高速储存与资料安全领域，协助企业加速迈向智慧化与数位转型。

科林研发携成大开设半导体课程，聚焦晶片制造关键技术

11月28日据《科技新报》报道，半导体设备大厂科林研发宣布，近日与国立成功大学智慧半导体及永续制造学院合作，为硕博士生开设《半导体制程技术原理与应用》课程。课程内容聚焦于半导体制造的关键技术，除介绍电浆蚀刻的基本概念与应用外，也协助学生掌握微影制程图案转移与高深宽比结构制造的核心原理，同时更探讨晶圆表面污染控制等化学清洗的重要性，为学生打下扎实根基。这次与成功大学合作开设的学分课程，是科林研发持续深耕培育新一代创新人才的重要里程碑。成功大学智慧半导体及永续制造学院的半导体制造技术学程副主任刘瑞农指出，透过科林研发讲师的授课，学生得以从产业视角了解半导体关键制程。期待未来持续深化双方合作，携手开设更多元的课程，进一步推动台湾半导体产业的永续发展。

陈立武强调半导体产业有工作，自由运用自身技术，欢迎罗唯仁重返团队

11月28日据《科技新报》报道，针对正式提告已退休的台积电前资深副总罗唯仁一事，已经接受罗唯仁返回入职的英特尔，由执行长陈立武发出内部信表示，英特尔一向秉持严格的政策与管控措施，明确禁止使用或转移任何第三方的机密资讯或智慧财产权，并严格遵守相关承诺。根据目前掌握的资讯，没有理由相信外界针对罗先生的指控具有任何根据。因此，英特尔欢迎罗唯仁重返团队。市场人士表示，陈立武在声明中特别提到，半导体产业发展至今，自由工作、运用自身技术专长、在企业间流动一直是产业创新的基石。人才在企业间的流动是业界普遍且健康的现象，这次情况也不例外。只是，目前英特尔还是必须依赖台积电的代工，除非英特尔已经完全准备好要完全切割与台积电的合作。否则，在关键的营业秘密方面未来预计会持续困扰未来双方的持续合作。

AI恐取代美国11.7%劳动力，白领工作影响最大

11月28日据《科技新报》报道，根据麻省理工学院的一项新研究，人工智能有潜力取代美国约11.7%的劳动力。这项研究模拟了超过1.51亿名美国劳工与AI工具的互动，并使用所谓的冰山指数来衡量自动化的潜力。研究于今年8月发表，涵盖923个职业的32,000项技能，并深入到全美3,000多个县市，超越了大型沿海城市的范畴。研究显示，自动化的影响主要集中在金融、行政和专业服

务等白领工作，这些行业的工资总额约为1.2兆美元。冰山指数揭示的劳动力影响程度比可见的科技采用规模大五倍。水面之上，表面指数追踪目前沿海科技中心的AI采用情况。水面之下，冰山指数衡量涵盖全国行政、金融和专业服务业的技术能力。这个隐藏的巨大部分代表，仅基于可见科技部门信号制定的劳动力准备策略可能会有所不足。

四、公司公告

立讯精密：向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告

公司于11月24日发布公告，立讯精密工业股份有限公司披露公司2025年股票期权激励计划的授予条件已成就。根据公告，本次激励计划经2025年5月13日股东会授权2025年11月23日董事会审议通过，以2025年11月21日为预留授予日，向符合条件的442名激励对象授予4,428.50万份股票期权，占公司总股本0.61%，约占拟授予权益总额19.99%，行权价格为25.15元/份。本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。公司表示，本次激励计划规定的预留授予条件已成就符合法律法规和规范性文件的规定，公司本次授予后，将按照相关要求在规定期限内进行信息披露并办理相应后续手续。

鸿富瀚：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告

公司于11月24日发布公告，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司披露控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张定武先生拟以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份。截至本公告披露日，张定武先生持有公司股份53,777,250股，占本公司总股本比例59.98%，股票来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。根据公告，张定武先生拟自减持预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内，即2025年12月16日至2026年3月15日，减持本公司股份合计不超过1,793,210股，占公司总股本比例2.00%。公司表示，本次减持计划符合相关法律法规及规范性文件的相关规定，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变化，后续公司将及时履行信息披露义务。

赛微电子：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

公司于11月24日发布公告，北京赛微电子股份有限公司披露公司收到持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的《关于股份变动比例触及1%整数倍的告知函》。根据公告，2025年9月23日至2025年11月24日，国家集成电路基金通过集中竞价方式合计减持其持有的公司股份7,836,718股，占公司总股本的1.07%。本次减持前，国家集成电路基金持有公司股份50,875,054股，占公司总股本的6.95%；本次减持后，国家集成电路基金持有公司股份43,038,336股，占公司总股本5.88%，持股比例变动触及1%整数倍。公司表示，本次减持符合相关法律法规及规范性文件的相关规定，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续经营产生重大影响。

中石科技：关于部分董事减持股份的预披露公告

公司于11月24日发布公告，北京中石伟业科技股份有限公司披露董事陈曲先

生、陈钰先生拟以集中竞价方式减持公司股份。根据公告，董事陈曲先生、陈钰先生合计持有公司股份1,451,574股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.49%，计划自本公告披露之日起15个交易日之后的三个月内，即2025年12月16日-2026年3月15日，减持公司股份合计不超过362,894股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.12%。公司表示，本次减持计划符合法律法规及规范性文件的规定，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构及持续经营。

润欣科技：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

公司于11月24日发布公告，上海润欣科技股份有限公司披露公司2025年11月24日临时股东大会审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公告，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，1人个人绩效考核得分 $85 > S \geq 75$ ，个人解除限售比例为60%，公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计5.40万股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由51,257.5047万股减少至51,252.1047万股，注册资本相应由人民币51,257.5047万元减少至人民币51,252.1047万元，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

翔腾新材：关于公司股东减持股份预披露公告

公司于11月25日发布公告，江苏翔腾新材料股份有限公司披露股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、股东上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）、股东深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）和股东上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份。截至本公告披露日，祥禾涌原持有公司股份4,304,254股，占总股本6.27%；上海泷新持有公司股份967,362股，占总股本1.41%；南山涌泉持有公司股份967,362股，占总股本1.41%；上海涌月持有公司股份486,394股，占总股本0.71%。上述股东拟在2025年12月17日-2026年3月16日，在任意连续90日内通过集中竞价方式减持合计不超过本公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持合计不超过本公司总股本的2%；集中竞价方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,060,604股，占公司总股本3%。公司表示，本次减持计划符合法律法规及相关规定的要求，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

好利科技：2025年前三季度权益分派实施公告

公司于11月25日发布公告，好利来（中国）电子科技股份有限公司拟实施2025年前三季度利润分配。本次权益分派以公司现有总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派0.280000元（含税），共计发放5,123,157.76元，不转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为2025年12月1日，除权除息日为2025年12月2日，A股现金红利由中国结算深圳分公司代派，公司股东汤奇青、旭昇亚洲投资有限公司的现金红利由公司自派。本次权益分派方案经2025年11月18日临时股东会审议通过。

*ST东晶：关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

公司于11月25日发布公告，浙江东晶电子股份有限公司披露股东“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）一宁聚映山红3号私募证券投资基金管理人”减持计划实施期限已届满。根据公告，截至2025年9月9日，宁波宁聚通过集中竞价交易方式合计减持公司股份2,327,982股，占公司总股本比例0.9563%，股份来源为通过协议转让方式取得的无限售条件股份，减持价格区间为9.89元/股至10.74元/股。公司表示，本次减持符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

鼎龙股份：关于公司部分董事兼高级管理人员减持股份预披露公告

公司于11月25日发布公告，湖北鼎龙控股股份有限公司披露董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士和董事兼财务总监姚红女士拟以集中竞价方式合计减持本公司股份。截至本公告日，杨平彩女士持有公司股份451,600股，占公司总股本0.05%；姚红女士持有公司股份321,250股，占公司总股本0.03%，两人合计持有本公司股份共772,850股，占本公司总股本0.08%。根据公告，上述股东拟自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，即2025年12月17日至2026年3月16日，合计减持本公司股份不超过335,000股，即不超过公司总股本比例的0.04%。公司表示，本次减持计划属于股东个人行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。

香农芯创：关于公司部分董事及高管减持股份预披露的公告

公司于11月25日发布公告，香农芯创科技股份有限公司披露公司董事、总经理李小红先生、董事、副总经理、财务总监苏泽晶先生和董事会秘书曾柏林先生拟以集中竞价方式减持公司股份。根据公告，李小红先生截至本公告日持有公司股份880,000股，占公司总股本0.189%，拟减持公司股份不超过220,000股，占公司总股本0.047%；苏泽晶先生截至本公告日持有公司股份120,000股，占公司总股本0.026%，拟减持公司股份不超过30,000股，占公司总股本0.006%；曾柏林先生截至本公告日持有公司股份80,000股，占公司总股本0.017%，拟减持公司股份不超过20,000股，占公司总股本0.004%。本次减持计划的减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的1个月内，即2025年12月17日-2026年1月16日。公司表示，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

工业富联：2025年第二次临时股东大会决议公告

公司于11月25日发布公告，富士康工业互联网股份有限公司披露2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东和代理人共7766人，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为89.3253%。根据公告，本次会议审议通过关于富士康工业互联网股份有限公司取消监事会暨修订《公司章程》、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》、关于《富士康工业互联网股份有限公司2025年半年度利润分配预案》四项议案。本次股东大会的召集和召开程

序相关法律、行政法规的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告

公司于11月26日发布公告，中节能万润股份有限公司披露公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司拟以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式增持公司股份。截至本公告日，中国节能持有公司股份212,376,951股，占公司当前总股本的23.01%；中国节能的全资子公司中节能资本控股有限公司持有公司股份20,100,366股，占公司当前总股本的2.18%；中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份232,477,317股，占公司当前总股本的25.19%。根据公告，中国节能计划自2025年11月24日起6个月内，即2025年11月24日至2026年5月23日，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。公司表示，本次增持计划符合法律法规及规范性文件的有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

智新电子：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告

公司于11月26日发布公告，潍坊智新电子股份有限公司披露公司拟调整2024年限制性股票激励计划回购价格。根据公告，公司2024年度权益分派方案已于2025年5月29日实施完毕，以公司股权登记日应分配股数106,100,000股为基数，向参与分配的股东每10股派0.60元人民币现金。本激励计划限制性股票的回购价格调整方法为调整前的每股限制性股票授予价格减去每股派息额。本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格为4.16元/股。本次调整经2025年11月25日董事会审议通过，审议程序合法合规，行使权益不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

思瑞浦：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

公司于11月26日发布公告，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司披露正在筹划以发行股份及/或支付现金的方式购买宁波奥拉半导体股份有限公司股权并募集配套资金。根据公告，本次交易可能构成重大资产重组，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2025年11月26日开市起开始停牌，公司定向可转换公司债券自2025年11月26日开市起停止转股，预计停牌时间不超过10个交易日。公司表示，目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一博科技：关于股东减持股份的预披露公告

公司于11月26日发布公告，深圳市一博科技股份有限公司披露股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份。截至公告披露日，领誉基石持有公司股份10,476,808股，占公司总股本的4.999999%。根据公告，上述股东拟自本公告披露之日起15个交易日后后的3个月内，即自2025年12月18日起至2026年3月17日，以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过2,083,767股，减持比例不超过公司总股本0.9945%；以大宗交易方式减持公司股份数量不超过4,167,534股，减持比例不超过公司当前总股本的1.9889%；合计不超过6,251,301股，减持比例合计不超过

过公司当前总股本2.9834%。公司表示，本次减持计划的实施不会对公司控制权、治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

思特威：2025年前三季度权益分派实施公告

公司于11月27日发布公告，思特威（上海）电子科技股份有限公司拟实施2025年前三季度权益分派。根据公告，本次利润分配方案经2025年11月14日股东大会审议通过，实际参与分配的股本数为401,304,700股，以该股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），以此计算合计拟派发现金红利50,163,087.50元（含税），不送红股、不转增股本；股权登记日为2025年12月2日，除权（息）日为2025年12月3日；无限售条件流通股的红利由中登上海分公司代派，有限售条件流通股股东之公司控股股东的现金红利由公司自行发放，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

江波龙：关于高级管理人员减持股份预披露公告

公司于11月27日发布公告，深圳市江波龙电子股份有限公司披露公司副总经理高喜春先生拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。截至公告披露日，高喜春先生持有公司股份122,592股，占公司总股本0.0292%。根据公告，高喜春先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年12月18日至2026年3月17日，合计减持公司股份不超过30,648股，占公司总股本0.0073%。公司表示，本次减持计划未违反法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响，公司将持续关注本次减持计划进展情况，并及时履行相应信息披露义务。

纬达光电：2025年第三季度权益分派实施公告

公司于11月27日发布公告，佛山纬达光电材料股份有限公司拟实施2025年第三季度权益分派。根据公告，本次权益分派以公司股权登记日应分配股数153,646,104股为基数，向参与分配的股东每10股派1.000000元人民币现金，共计派发现金红利15,364,610.40元；权益登记日为2025年12月5日，除权除息日为2025年12月8日；A股现金红利由中国结算北京分公司代派，佛山佛塑科技集团股份有限公司、佛山市三水区星纬投资有限公司、AOE Holding Limited、ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION的现金红利由本公司自行派发。本次权益分派方案已获2025年11月20日股东会审议通过。

易德龙：苏州易德龙科技股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告

公司于11月28日发布公告，苏州易德龙科技股份有限公司披露持股5%以上股东王明先生计划通过大宗交易方式减持公司股份。本次减持计划实施前，王明先生持有公司股票20,507,160股，占公司总股本12.78%，股票来源为公司首次公开发行前持有的股份，均为无限售流通股。根据公告，王明先生计划于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，减持公司股份数量合计不超过3,200,000股，不超过公司股份总数的2%。公司表示，本次减持计划系王明先生因自身资金需求自主决定，不会导致公司控制权发生变更，后续公司将及时履行信息披露义务。

拓荆科技：2022年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告
 公司于11月28日发布公告，拓荆科技股份有限公司披露2022年股票增值权激励计划第三个行权期的行权条件已成就。根据公告，公司于2022年11月22日向3名激励对象以47.31元/股的价格授予87.6160万份股票增值权，约占公司目前股本总额28,116.3930万股的0.31%，本次可行权数量为21.9040万份，行权期为2025年11月24日至2026年11月20日。公司表示，本次归属条件已成就经2025年11月27日董事会审议通过，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、下周重要事件提示

表3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	2025 “人工智能+”产业生态大会	12.1-12.3	北京市	中国互联网协会
2	国际电子电路（深圳）展览会	12.3-12.5	深圳市	香港线路板协会等
3	2025 全球智能机械与电子产品博览会	12.4-12.6	珠海市、澳门特别行政区	中国电子商会

公司会议				
序号	公司名称	会议名称	会议时间	
1	奋达科技	股东大会举办	2025-12-05	
2	金龙机电	股东大会举办	2025-12-05	
3	中颖电子	股东大会举办	2025-12-05	
4	逸豪新材	股东大会举办	2025-12-05	
5	鸿日达	股东大会举办	2025-12-05	
6	弘景光电	股东大会举办	2025-12-05	
7	依顿电子	股东大会举办	2025-12-05	
8	安凯微	股东大会举办	2025-12-05	
9	朗特智能	股东大会举办	2025-12-04	
10	凤凰光学	股东大会举办	2025-12-04	
11	生益电子	股东大会举办	2025-12-04	
12	华特气体	股东大会举办	2025-12-04	
13	盛科通信	股东大会举办	2025-12-04	
14	华岭股份	股东大会举办	2025-12-04	
15	华塑控股	股东大会举办	2025-12-03	
16	宝明科技	股东大会举办	2025-12-03	
17	三环集团	股东大会举办	2025-12-03	
18	立昂微	股东大会举办	2025-12-03	
19	普冉股份	股东大会举办	2025-12-03	
20	国星光电	股东大会举办	2025-12-02	

21	赛微微电	股东大会举办	2025-12-02
22	复旦微电	股东大会举办	2025-12-02
23	卓翼科技	股东大会举办	2025-12-01
24	联动科技	股东大会举办	2025-12-01
25	莱特光电	股东大会举办	2025-12-01

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表4: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		解售股份类型
					流通A股	占比(%)	流通A股	占比(%)	
688652.SH	京仪装备	2025-12-01	168.00	16,800.00	11,907.00	70.88	12,075.00	71.88	首发战略配售股份
688449.SH	联芸科技	2025-12-01	22,320.41	46,000.00	7,000.00	15.22	29,320.41	63.74	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
920128.BJ	胜业电气	2025-12-01	5,923.00	8,119.00	2,196.00	27.05	8,119.00	100.00	公开发行原股东限售股份, 公开发行战略配售股份
002947.SZ	恒铭达	2025-12-05	18.54	25,620.93	19,240.46	75.10	19,259.00	75.17	股权激励限售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准:

增持: 行业股票指数在未来6个月内超越大盘;

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15% 以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 -5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 -5%~+15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。